

レーザーカットによるL/S=20/20 μ mの極細線電極回路形成

レーザー加工用Agペースト

Silver Paste for laser-process application can achieve ultra-fine circuit L/S of 20/20 μ m

激光加工用銀漿 通過激光切割形成線寬線距 20/20 μ m的極細線電極線路

特徴 Features/特徴

- **レーザーによるカット性に優れ低出力で綺麗に加工が可能。**
Excellent laser-cut property enables immaculate processing even at low power output./激光切割性優越,在低功率下還能獲得漂亮的切割效果
- **銀粉の分散性を向上させ、カット後のスペース上に残るAgの粗大粒子数を削減。**
Improved dispersibility of silver powder; reduced number of large Ag particles left behind on spaces after cutting./
提高了銀粉的分散性,削減切割後在間隔上殘留的銀粗大顆粒數
- **硬化塗膜タイプ** Cured coated film type/熱固型

仕様 Specifications/規格

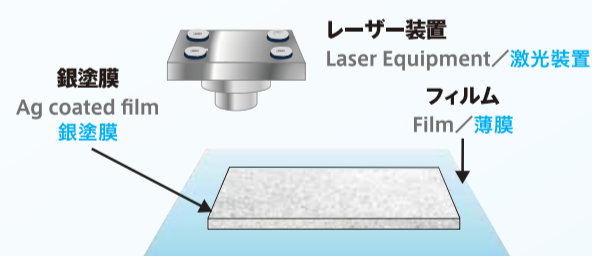
特性項目 Characteristic items/特性項目	LS-490L	SNP-100L	備考 Remarks/備註
特徴 Features/特徴	汎用品グレード General-purpose grade/通用品級	高Tgグレード High Tg grade/高Tg品級	—
粘度(25℃) Viscosity/黏度	400dPa·s	400dPa·s	VT-06 type VT-06型
硬化条件 Curing condition/固化條件	130℃×30min	130℃×30min	熱風循環式乾燥炉 Hot air circulating drying oven/熱風循環式乾燥爐
塗膜タイプ Coated film type/塗膜型	熱硬化 Heat cure type/熱固型	熱硬化 Heat cure type/熱固型	—
加工性 Processability/加工性	20/20 μ m	20/20 μ m	L/S
面積抵抗値 Sheet Resistivity/面積阻抗值	60m Ω /□	60m Ω /□	膜厚10 μ m換算 Converted as 10 μ m thickness/膜厚10 μ m換算
密着性(PET/ITO/Glass) Adhesiveness/密著性(PET/ITO/Glass)	100/100	100/100	クロスカット・テープピール Cross-cut, tape peel/百格膠帶

用途 Application/用途

- **レーザー工法によるタッチパネルの額縁電極形成用**
To form frame electrode on touch panel via laser-cut technique/通過激光工藝 用於形成觸控面板的邊框電極

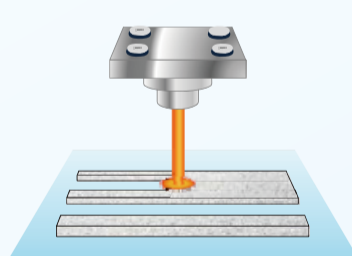
使用例 Usage Application/使用例子

①スクリーン印刷 Screen printing/絲網印刷



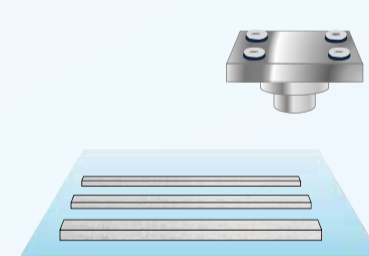
- ・従来の印刷程度
Conventional printing level/
往來的印刷程度
- ・細線ない為、粘度低め
No fine-lines, so, viscosity is lower/
無細線, 因此粘度偏低

②レーザーカット Laser cut/激光切割



- ・不要な銀塗膜をカット
Cut away unwanted Ag coated film/
將不需要的銀塗膜切割掉
- ・わずかな時間レーザー照射
Only a short period of laser irradiation/
僅短時間激光照射

③回路形成 Circuit formation/形成線路



- ・細線形成
Fine-line formation/
形成細線

レーザー加工例 Example of laser processing/激光加工例子(L/S=20/30 μ m)

